

| | | | |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Spannung: | 230 V AC | Schutzart: | IP X7 |
| Leistung (Matte): | 70 – 160 W/m ² | Schutzmaßnahme: | FI-Schutzschaltung mit 30 mA |
| Leistung (Leiter): | 8 – 12 W/m | Absicherung: | 10 A (B-Charakteristik) |
| Mattenbreite: | 0,40 / 0,50 m | Mindestverarbeitungstemp.: | + 5°C |
| Abmessung (Leiter): | ø ca. 3,2 mm | Trägermaterial: | Glasgittergewebe |
| Biegeradius: | mind. 25 mm | Prüfspannung: | 2.500 – 4.000 V |
| Nenngrenztemperatur: | + 90°C | | |

Untergrundvorbehandlung

| Art | Vorgehensweise |
|---|---|
| Alte Belagsreste | Lose Teile entfernen, fest haftende Teile belassen, grundieren und trocknen lassen. Vor dem Verlegen von Marmor alte Belagsreste entfernen oder mit einer lösungsmittelfreien 2-Komponenten-Grundierung absperren. |
| Alte Keramik-, Betonwerkstein- und Natursteinbeläge (nur gut haftende Beläge) | Auf Hohlräume überprüfen, Fett-, Wachs- und Schutzschichten entfernen, grundieren und trocknen lassen. |
| Zementestriche (Restfeuchte beachten) | Staub, Schmutz, Zementleimschichten etc. entfernen, bei eventuellen Risse diese entweder kraftschlüssig verschließen und aushärten lassen oder Estrich mit einer Entkopplungsmatte überkleben. |
| Beton und Stahlbeton | Staub, Schmutz, Zementleimschichten etc. entfernen; eventuell Stahlkugelstrahlen; bei starker Saugfähigkeit grundieren und trocknen lassen. |
| Anhydrit- und calciumsulfatgebundene Estriche (max. Restfeuchte 0,5%) | Bei eventuellen Rissen diese entweder kraftschlüssig verschließen, oder nach dem sachgerechten Anschleifen und Reinigen grundieren und mit einer Entkopplungsmatte überkleben. |
| Gussasphaltestriche | Staub, Schmutz und andere Trennschichten entfernen (z.B. durch Schleifen oder Strahlen), grundieren und trocknen lassen. |
| Holzdielenboden | Staub und Schmutz entfernen, Dielenfugenverschließen, grundieren, leichtverlaufende Spachtelmasse aufbringen und Entkopplungsmatte verkleben. |
| Holzspanplatte | Staub und Schmutz entfernen; die Holzspanplatte (V 100) muss mindestens 25 mm dick und mit einem Schraubenabstand von max. 40 cm auf der Unterkonstruktion befestigt sein. Anschließend Grundierung auftragen, trocknen lassen und darauf Entkopplungsmatte verkleben. |

Hinweis: Verlege- und Fugenmörtel, Spachtel- und Ausgleichmassen, Entkopplungsmatten sowie Dämmstoffe erhalten Sie im Baustoff- und Fliesenfachhandel. Die Hersteller-Vorschriften (Verarbeitungshinweise) der Produkte sind zu beachten!